**IDEAS Hatch「準量產」雛型打造申請表**

**\*為必填欄位**

|  |
| --- |
| **團隊資料** |
| **\*** | **團隊/公司名稱** |  |
| **\*** | **團隊類型** | **□新創組(已成立公司) □新創組(未成立公司) □校園組** |
| **\*** | **國家** |  |
| **\*** | **團隊所在地**(請填寫主要生活所在的城市) |  |
|  | **網站** |  |
| **\*** | **聯絡人** |  |
| **\*** | **電話** |  |
| **\*** | **Email** |  |
| **\*** | **成員介紹** | **姓名** |  |
| **專長** |  |
| **經歷** |  |
| **本專案負責項目** |  |
| **本專案投入程度** | **□**Full time  **□**Part time |
| **\*** | **平均每週在本專案所投入的時間** | **是否有固定聚會時間? □是 □否****請描述：** |
| **\*** | **推薦人/單位**(若有，請填寫加速器/育成機構/企業/學校/特定對象之相關資料，並將優先審核；如無，請填無) | **單位：** |  |
| **姓名：** |  |
| **電話：** |  |
| **E-mail：** |  |
| **\*** | **目前是否參與其他相關輔導方案或進駐相關機構空間?** | **□是，請說明：****□否** |
| **\*** | **最方便參與哪一地區的輔導活動?** | **□北部(台北) □中部(台中) □南部(高雄)** |
| **\*** | **如何得知本平台輔導機制?** | **□網路搜尋 □Facebook ideas Hatch粉絲頁 □朋友介紹 □本平台主動接洽 □其他** |

|  |
| --- |
| **產品基本介紹** |
| **\*** | **產品/服務名稱** |  |
| **\*** | **產品服務類型** | **□智能玩具/教具/機器人****□智慧健康/穿戴****□智慧門店/大型場域應用****□智慧居家/生活/城市****□智慧寵物****□聯網車輛應用****□智慧工廠/傳產轉型****□智慧文創商品****□智慧農漁養殖****□其它** |
| **\*** | **產品發展階段****(複選)** | **□還只是構想****□雛形階段**(還不會動)**□雛形階段**(會動，使用開源軟硬體解決方案、缺少外觀設計)**□工程樣品**(具備基本外觀，可操作結構mockup、已經歷至少一次PCB佈局)**□設計驗證樣品**(已可被定義為模具品，完成法規/可靠度/相容性/效能pre-test**□準備小量生產****□準備大量生產** |
| **\*** | **產品簡介與功能介紹** |  |
| **\*** | **產品規格說明** | **尺寸** | (請提供產品長、寬、高之規格) |
| **雲端平台** | (若無，請填無) |
| **軟體** | **\*類型** | **□App □桌面應用程式 □web應用程式 □其他**  |
| **細部描述**  |  |
| **硬體** | **\*類型** | **□晶片 □模組 □開發板** |
| **\*國家別** | **□台灣 □中國 □美國 □其他**  |
| **\*廠牌** |  |
| **\*型號** |  |

|  |
| --- |
| **產品市場與營運分析** |
| **\*** | **產品最大賣點、哪裡最為創新** |  |
| **\*** | **產品之商業模式為何?** |  |
| **\*** | **現階段產品開發過程中，就技術面遭遇的最大問題為何? 現在或未來是否有解決方案?** |  |
| **\*** | **產品可能的競爭者是誰？** |  |
| **\*** | **這個產品跟其他競爭者相比，核心優勢是什麼？** |  |
| **\*** | **在未來六個月至一年間產品首要欲完成之目標(如有一年後之規劃亦可補充說明)** |  |
| **\*** | **產品是否已進入場域/市場驗證?(請說明合作場域及驗證期間)** | **□是，請說明：****□否** |
| **\*** | **目前是否具備既有客戶/潛在客戶?(請說明客戶名稱、客戶之產業類型等、及目前接洽狀況)** | **□是，請說明：****□否** |

|  |
| --- |
| **\*請描述專案目前缺少的資源、現況、及因缺少該資源可能遭遇的問題** |
|  | **□軟體技術** | **說明：** |  |
|  | **□晶片模組** | **說明：** |  |
|  | **□電路設計與Layout** |  |  |
|  | **□產品設計(外型/機構)** | **說明：** |  |
|  | **□雛型打樣** | **說明：** |  |
|  | **□小量試產** | **說明：** |  |
|  | **□大量生產** | **說明：** |  |
|  | **□銷售(國內/外)** | **說明：** |  |
|  | **□募資** | **說明：** |  |
|  | **□國際行銷** | **說明：** |  |
|  | **□其他** | **說明：** |  |
| **相關圖片** | 請提供1-5張實際圖/概念圖/合成圖/機構圖，圖片越詳細越好，以加強我們對您產品各層面的理解 |
|  |
| **產品影片** | 如有產品相關之影片(產品進度、服務情境)，請提供影片連結 |
| **其他附件** | 請上傳產品的相關介紹附件(格式不拘)，加強我們對您產品服務的理解，以利審核 |
| **備註/其他說明** |  |

※線上申請方便又快速：<http://www.ideas-hatch.com/mem_proposal.jsp>

※如您選擇線下申請 :

* 請填妥申請表格後，請email申請表至nicolechtsui@iii.org.tw
* 請簽署【附件一、經濟部工業局蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書】、【附件二、提案同意書】，並將正本文件郵寄至下列地址：

財團法人資訊工業策進會 數位服務創新研究所
台北市松山區民生東路4段133號8樓

※如有相關疑問，請聯繫本案窗口：崔小姐，nicolechtsui@iii.org.tw /02-6607-2574

**附件一、**

**經濟部產業發展署**

**蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書**

版本：P- CV24010123-1 -DTRI

**經濟部產業發展署(下稱本署)**為遵守個人資料保護法令及本署個人資料保護政策、規章，於向您蒐集個人資料前，依法向您告知下列事項，敬請詳閱。

1. 蒐集目的及類別

本署因辦理或執行｢高階智造生態系統聯盟暨國際化推動計畫｣業務、活動、計畫、提供服務及供本署用於內部行政管理、陳報主管機關或其他合於本署捐助章程所定業務、寄送本署或產業相關活動訊息之蒐集目的，而需獲取您下列個人資料類別：姓名、E-mail、公司/學校、手機

1. 個人資料利用之期間、地區、對象及方式

 除涉及國際業務或活動外，您的個人資料僅供本署於中華民國領域、在前述蒐集目的之必要範圍內，以合理方式利用至蒐集目的消失為止。

1. 當事人權利

您可依前述業務、活動所定規則或依以電子郵件方式（崔小姐，nicolechtsui@iii.org.tw）向本署行使下列權利：

1. 查詢或請求閱覽。
2. 請求製給複製本。
3. 請求補充或更正。
4. 請求停止蒐集、處理及利用。
5. 請求刪除您的個人資料。
6. 不提供個人資料之權益影響

若您未提供正確或不提供個人資料，本署將無法為您提供蒐集目的之相關服務。

1. 您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本署留存此同意書，供日後取出查驗。

**個人資料之同意提供：**

一、本人已充分獲知且已瞭解上述貴署告知事項。

1. 本人同意貴署於所列蒐集目的之必要範圍內，蒐集、處理及利用本人之個人資料。

立同意書人：

中華民國 年 月 日

**附件二、**

**提案申請同意書**

立同意書人同意就其參加財團法人資訊工業策進會（以下簡稱「資策會」）舉辦IDEAS Hatch推動方案（以下簡稱本活動），依下列授權條款授權及提供個人資料予資策會使用：

1. **肖像權授權部分：**
2. 授權內容：立同意書人同意資策會為執行本活動，有拍攝、使用、於公開平台展示立同意書人肖像之權利。
3. 授權期間/地域：不限期間及地域永久授權。
4. 授權條件：無償授權。
5. **著作權授權部分：**
6. 授權內容：本活動中立同意書人創作之著作（以下簡稱其著作），包含重製權及改作權。立同意書人同意資策會為執行本活動，有使用、予本活動評審展示立同意書人其著作之權利。
7. 授權期間/地域：不限期間及地域永久授權
8. 授權條件：無償授權
9. 立同意書人擔保其著作係其原創性著作，且未侵害任何第三人之智慧財產權。如其著作有利用他人之著作，立同意書人保證已取得他人之同意或授權，並有授權資策會依本同意書內容使用之權利，並同意對資策會不行使著作人格權。
10. 如有因違反本同意書致資策會受有損害，立同意書人應負所有賠償責任（包括但不限於律師費、訴訟費用、和解金、賠償金等）。
11. 若因本同意書而引起之疑義或糾紛，立同意書人同意依誠信原則解決之。凡因本同意書或違反本同意書所引起的糾紛、爭議或歧見，立同意書人同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院，並以中華民國法律為準據法。

此 致

財團法人資訊工業策進會

立同意書人：

中華民國 年 月 日